

SWCC 株式会社 テーマ別説明会 Q&A

実施日時：2026年3月16日（月）

第一部 14：30～15：30／第二部 16：00～17：00

実施場所：東京都中央区日本橋兜町

中計全体

Q 中計目標に対する所感（ストレッチが効いた目標か、保守的な達成確度が高い目標か）について教えてほしい。

A 2030年目標はストレッチが効いた目標。既存中計（FY2026目標）は1年前倒しで2025年度中に達成できる見込み。これまではROICを活用し、悪いところを見つけ出し構造改革をしてきた。新中計では、構造改革だけでは届かないレベルの成長を目指す。半導体など新たな成長領域への参入、インオーガニック成長（M&A等）への挑戦、海外売上比率を現状の10%→20%（FY2030）へ拡大を目指すというチャレンジングな目標。

通信・コンポーネッツ事業

Q 通信・コンポーネッツ事業の利益成長の確度は。

A 売上高1,376億円、営業利益83億円（FY2025E）を売上高1,770億円、営業利益176億円（FY2030F）まで上げる計画だが、通信ケーブルはデータセンター向けの市場、特にハイパースケールデータセンター（以下、HSDC）の構築に向けて今後も好調が見込まれる。その市場においてはe-Ribbon[®]が主に牽引していく。e-Ribbon[®]だけにとどまらず、ケーブル化、応用製品等々の拡販も計画している。モビリティ、産業用の事業は刷新・課題事業として捉えており、利益率をどう改善していくかが重要になる。今後2年間の中で方向性を見極めていきたい。

Q 通信事業について、データセンター市場での立ち位置について教えてほしい。

（HSDCにどの程度採用されているのか、契約形態、共同開発状況など）。

A e-Ribbon[®]は高密度配線に使われており、データセンター内外に拡大している状況。欧州・アジア・北米のグローバルメーカーと長期契約を締結している。世界的に光ファイバー不足ではあるが、パートナー企業から安定調達が可能である。当社はパートナーから光ファイバーを入手し、それをe-Ribbon[®]に加工するという立ち位置。今後、ケーブル、応用製品はお客様と一緒に開発していく。具体的なシェアは非公表だが「かなり大きなシェア」獲得を目指し進めている。

Q データセンター需要が2030年まで継続した場合に設備増強する必要があるのか。また、2030年以降もe-Ribbon[®]は主力事業であり続けるのか。

A 2025年の生産能力の7倍まで拡大できるほどの長期契約の話をもっている。HSDC需要が急激に伸びていく2030年までの間、需要を捕捉できるが重要と考える。2030年以降は需要見通しが各社で分かれるが、今は限られている供給メーカーも増えてくることも想定する必要がある。その

観点から、価格競争力を考慮した投資が必要となると考えている。ただし e-Ribbon[®]の技術はテレコム等インフラ用途へも展開可能なので中長期でも需要減は想定していない。

Q **半導体事業の拡販戦略は。**

(ロジック向け/メモリー向け、地域などの重点領域)

A 現在の主力は後工程のパッケージ基板向けワイヤープローブ。かなり細かいピン径を要求されており、さらなる開発を行っている。

FY2026F-2027F には、前工程の MEMS が主力になってくると思われる。現在開発中であるが、TOTOKU は高い量産技術を持っており、早い段階で市場に投入していきたい。

Q **半導体事業の売上高 80 億円 (FY2025E) の内訳を教えてください。**

A 売上 80 億円の内訳はコンタクトプローブと高周波ケーブル・同軸ケーブルが約 1/3、残り 2/3 が除振台やバーンインソケットなど。

Q **半導体検査装置関連市場においてグループ会社の製品を拡販することだが、その中で注目度の高い重点領域は。**

A 特に伸ばしていきたいのは除振台。高加速度対応に加え、モニタリング機能、故障予知、オートチューニング機能を付加することで売り切りモデルからの転換を図る。

Q **コンタクトプローブの優位性と今後のシェア拡大の確度は。**

A 独自の超極細径加工技術とそれを量産できることが優位性である。コスト競争力も高く、前工程～後工程まで一貫供給できる点も強み。国内 2 大メーカーには既に大量供給しており、今後は TOTOKU の中国拠点にも投資していきながら、中国検査装置メーカー向けに供給していこうと考えている。

Q **コンタクトプローブの主要用途とシェア、ポジショニングについて教えてください。**

A 今はメモリー/ロジック向け問わず、様々な用途で使われている。2027 年に向けて、前工程の MEMS という形のプローブピンが主力になってくるという話もあるが、当社は高い加工技術を強みとして、確実に需要を捕捉していく。シェアについては、ワイヤープローブで世界シェア 35%程度（当社調べ）。一方、前工程向けのシェアというのはまだまだ高くない。前工程向けのシェアをいかに伸ばしていくかがポイント。

エネルギー・インフラ事業

Q **電力インフラ事業の収益性向上の牽引役は。**

(既存事業が中心になるのか新事業が中心になっていくのか。また既存市場への参入か新市場を作っていくのか)

- A 変電市場では既に高シェアを確保し、拡大余地は限定的。今後の成長の牽引役は送電市場である。送電市場は既存市場であるが、高経年ケーブルの更新時期に入っており、需要が増加する見込み。また、データセンター向け 154kV の Y 分岐接続部については、SICONEX[®]を応用した独自技術であり、収益性も高く当社が新市場を作っていく。現在開発中であるが、来年度には市場投入していきたい。レトロフィット SICONEX[®]は、納期問題で苦労している既存機器にも対応できる SICONEX[®]であり、これについても収益性に期待している。
- Q **電力インフラ事業において、中国、韓国など海外変電メーカーが日本に参入してくるリスクは実際にどの程度あるのか。**
- A 既に参入しているのは市場のうちの 1~2%程度と想定している。信頼性という点において、電力会社、あるいは機器メーカーも全てを海外メーカーに移していくことは考えていないようだ。
- Q **送電市場とデータセンター向け電力市場における競合企業はどこか。**
- A 超高压製品の製造および工事が可能な会社は当社含めて 3 社のみ。
- Q **送電市場と海外市場での需要獲得の確度は。**
- A 送電市場では、油入りの絶縁ケーブルから CV ケーブルへの更新の需要拡大が見込まれているが、当社含めて 3 社しかできない。競合は風力発電等大規模な再エネ向けに注力しており、確度は非常に高いと考える。
- Q **e-Cable[®]と Y 分岐接続部はセット販売か。**
- A データセンター向けには e-Cable[®]と Y 分岐接続部のセット販売を想定している。e-Cable は施工性が上がるので、データセンター向けだけでなく幅広く利用してもらえると考えている。
- Q **データセンター向け Y 分岐接続部の拡販の確度は。**
- A 66kV 領域で既に高シェアを保有。154kV 向けは電力会社と協議中で、早期市場投入を強く要望されている。
- Q **Y 分岐接続技術は海外でもあまり例はないのか？ 御社独自のものなのか？**
- A 日本特有の技術だと思っている。66kV では高い評価を受けており、国内では 90%のシェアを持っている。今後は 154kV 以上で採用拡大を目指す。今の段階では海外展開までは考えていない。
- Q **SICONEX[®]の海外展開における戦略について教えてほしい。**
- A 海外で SICONEX[®]を展開するにあたっては、日本のように「ケーブル・SICONEX[®]・工事」をセットで拡大していくモデルは成立しないと考えている。そのため、海外では SICONEX[®]単体を中心に据え、施工性と価格競争力を備えた製品を海外メーカーと協業しながら展開していきたい。なお、この取り組みは中期経営計画期間の後半での展開を目指す。

Q 米国ではデータセンター内に自前の発電所を設置する動きが広がっているが、日本で同様の動きが起きた場合、どのような影響が考えられるか。その海外での動きは SICONEX[®]の海外展開していくきっかけになるのか。

A SICONEX[®]の海外展開については、それに向けて製品化を進めている状況であり、市場投入はもう少し先になる。データセンターの早期建設・稼働を行う必要がある状況下においては、施工能力が大きな課題になる。施工性が非常に高い e-Cable[®]や Y 分岐接続部という新しい接続技術を組合せながら提案可能という点で、自前で電力供給というような動きがあっても、非常に高い優位性を持っていると考えている。

Q 海外向け SICONEX[®]について日立との棲み分けは考えているのか。

A 海外進出している日系メーカーもそうだが、海外にも地場の会社がある。選択肢としては広く考えていきたい。

その他

Q 超電導技術の進展について教えてほしい。

A 線材の供給からスタートし、大手化学メーカーの工場で超電導素材を使ったケーブルを活用した実証実験も実施済み。現在も国との共同研究で新しい商品化の検討もしている段階である。